



主要特点

延时量: 444.44 ps / 1440° @ 9 GHz

延时精度: ± 10 ps

延时相位精度: $\pm 30^\circ$

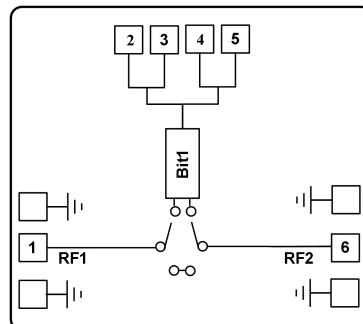
插入损耗: 6 dB

移相幅度调制: ± 0.8 dB

输入/输出: 50 Ohm 匹配

芯片尺寸: $2.5 \times 2.0 \times 0.075$ mm³

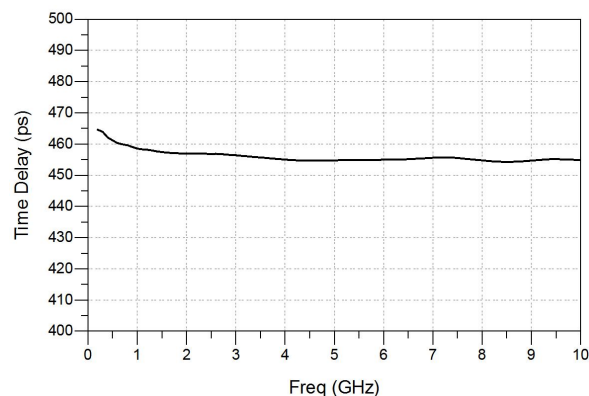
功能框图



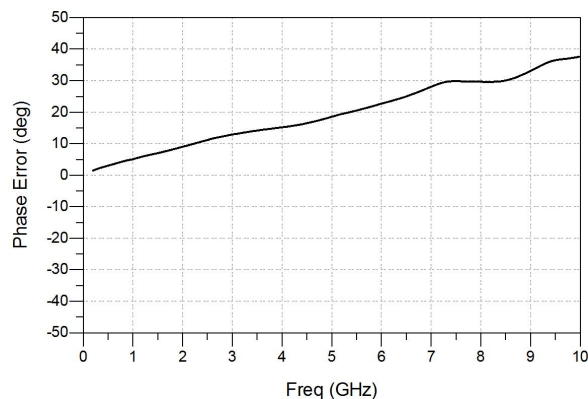
性能指标 ($T_A = +25^\circ\text{C}$, $V_{CTL} = 0 / +5$ V)

参数	最小	典型	最大	单位
频率范围	1 - 10			GHz
插入损耗		6		dB
延时精度		± 10		ps
移相幅度调制		± 0.8		dB
输入输出驻波比		1.4		-
输入功率 1dB 压缩点		24		dBm
切换时间		30		ns

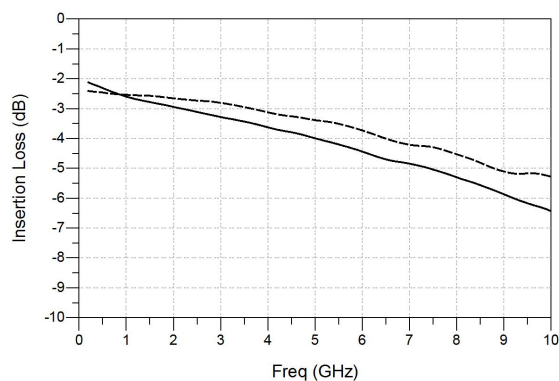
延时量



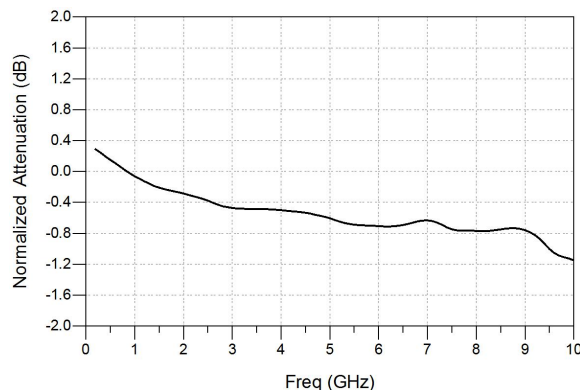
延时相位误差



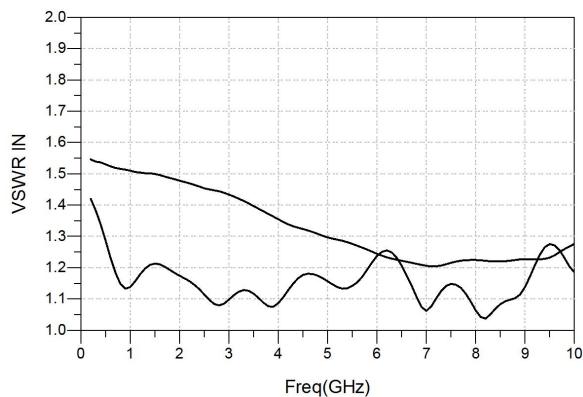
插入损耗



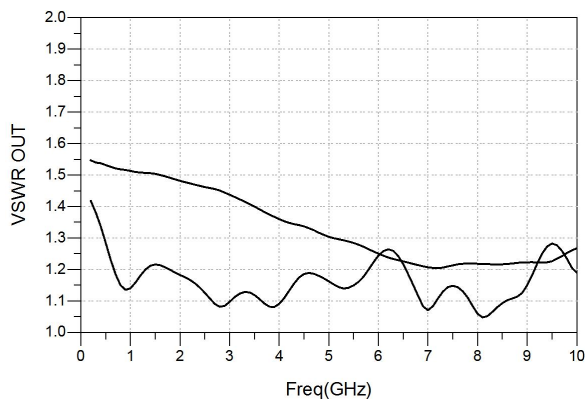
幅度调制



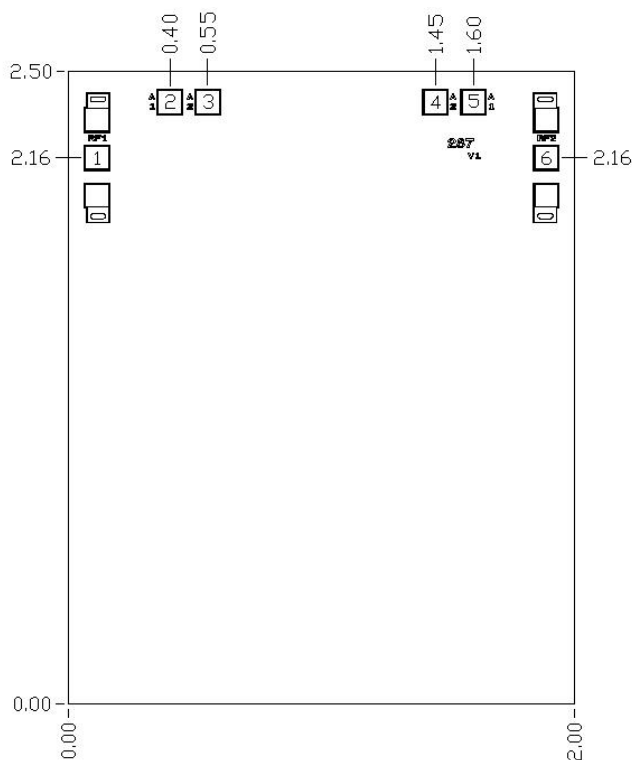
RF1端口驻波比



RF2端口驻波比



物理参数



焊盘描述

焊盘序号	功能	描述
1, 6	RF1, RF2	该焊盘是射频端口, DC 耦合并匹配至 50 Ohm, 如果 RF 电位不是 0V, 那么需要外部加入隔直电容
2、5	A1	A1=0V, A2=-5V 时 444.44ps 关闭; A1=-5V, A2=0V 时 444.44ps 打开 使用时 2、5 两个焊盘中任选一个键合, 3、4 两个焊盘中任选一个键合
3、4	A2	
芯片背面	GND	芯片背面必须连接至 RF/DC 地

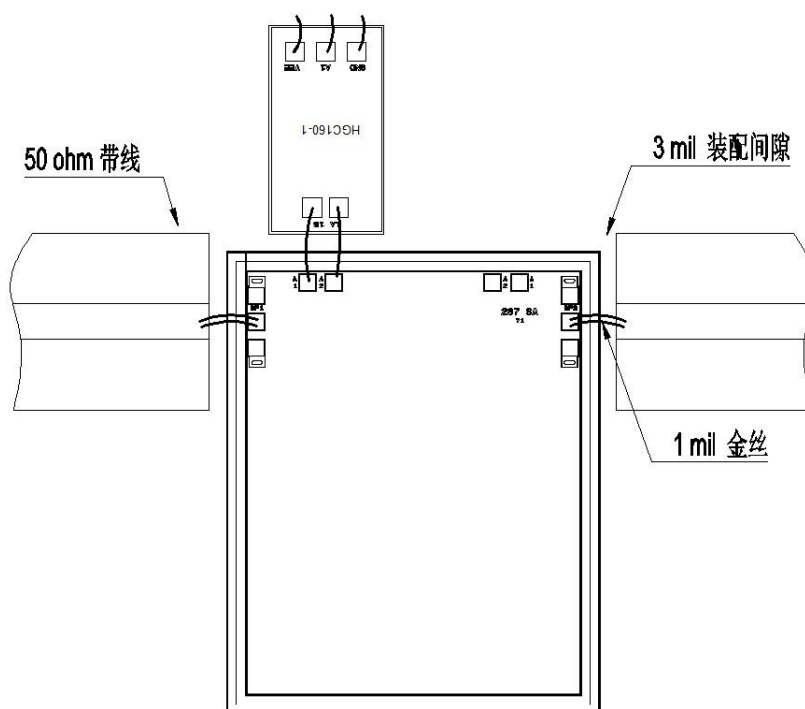


真值表

状态	444.44ps	
	A1	A2
参考态	0	1
444.44ps	1	0

“0” 电平范围: 0~-0.2V; “1” 电平范围: -3~-6V

推荐装配图



注意事项

1. 芯片厚度为 75 μm
2. 典型键合焊盘尺寸为 $100 \times 100 \mu\text{m}^2$
3. 键合焊盘金属化: 金
4. 芯片背面镀金
5. 芯片背面接地
6. 未标注的键合焊盘不需要连接

极限参数

1. 射频输入功率: +24 dBm
2. 储存温度: -65 ~ +150°C
3. 工作温度: -55 ~ +85°C